

半導体装置向け拡充

真空部品 組み付け 丸和機械、第2の柱に

【名古屋】丸和機械（名古屋市緑区、杉山貴浩社長）は、8月にも半導体製造装置向け真空部品の組み付けを始める。主力である大手自動車部品メーカーの製造ライン向け特注部品で培った精密切削加工技術などを応用。すでに2022年から同真空部品の加工・製造に着手しており、組み付けも手がけることで付加価値と収益の向上を狙う。半導体製造装置向け事業を第2の柱に育成し、25年12月期には全売上高の10%を同装置向けで稼ぐことを目指す。

スマートフォンの高機能化や自動車のC/A S/E（コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化）対応により、半導体の需要は中長期で伸びる見込み。丸和機械は自動車部品

メーカーの製造設備向け部品が主力事業だが、精密加工技術を駆使し、成長が期待できる半導体製造設備向け事業にも乗り出す。同社の22年12月期の売上高は約13億円。

年5月にリークディテクター（漏れ検査装置）を導入した。1立方メートル中に粒径0.5μm以下のマイクロは100万分の1）以上のゴミが200個以下の清浄度を實現する。

併せて鏡面研磨機や測定器も導入。同社が供給する真空部品は面粗さが重要となる。表面の加工が粗いと空気が残り良好な真空状態にできないため、仕上げのための鏡面研磨機と、品質保証のための3次元（3D）形状測定器を導入した。



丸和機械が本社工場に新設したクリーンルーム

真空部品の組み付けに当たり、約2000万円を投じ、本社工場内に約6平方メートルのクリーンルームなどを新設した。設計室だった場所を22年12月にクリーンルームに改修し、23